

# 2022-2027年中国ic先进封装行业市场全景评估及 发展战略规划报告

报告大纲

## 一、报告简介

华经情报网发布的《2022-2027年中国ic先进封装行业市场全景评估及发展战略规划报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/electric/780755.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分 产业动态聚焦

第一章 IC封装产业相关概述

第一节 IC封装涵盖

第二节 IC封装类型阐述

一、SOP封装

二、QFP与LQFP封装

三、FBGA

四、TEBGA

五、FC-BGA

六、WLCSP

第三节 明日之星——TSV封装

一、TSV简介

二、TSV与SoC

三、TSV产业与市场

第二章 2021年世界IC封装产业运行态势分析

第一节 2021年世界IC封装业运行环境浅析

一、全球经济大环境及影响分析

二、全球集成电路产业运行总况

第二节 2021年世界IC封装运行现状综述分析

一、IC封装产业热点聚焦

二、IC封装业新技术应用状况分析

三、全球IC封装基板市场分析

四、全球IC封装材料市场发展

五、全球IC封装生产企业向中国转移

第三节 2021年世界IC封装重点企业运行分析

一、英特尔（Intel）

二、IBM

三、超微

#### 四、英飞凌 (Infineon)

##### 第四节 2022-2027年世界IC封装业趋势探析

#### 第三章 2021年中国IC封装行业市场运行环境解析

##### 第一节 2021年中国宏观经济环境分析

##### 第二节 2021年中国IC封装市场政策环境分析

###### 一、电子产业振兴规划解读

###### 二、IC封装标准

###### 三、内需拉动力，IC业政策与整合是关键

###### 四、相关行业政策及对IC封装产业的影响

##### 第三节 2021年中国IC封装市场技术环境分析

###### 一、高端IC封装技术

###### 二、中高端IC封装技术有所突破

###### 三、IC封装基板技术分析

#### 第四章 2021年中国IC封装产业整体运行新形势透析

##### 第一节 2021年中国IC封装产业动态聚焦

###### 一、半导体封装基板项目落户无锡

###### 二、国内IC封装及IC基板用硅微粉实施产业化

###### 三、中国IC代工封装等已进入国际排行榜

##### 第二节 2021年中国IC封装产业现状综述

###### 一、我国IC封装业正向中高端迈进

###### 二、探密中国IC封装产业变局

###### 三、中国正成为全球IC封装中心

###### 四、IC封装年产能分析

##### 第三节 2021年中国IC封装产业差距分析

###### 一、工艺技术

###### 二、质量管理

###### 三、成本控制

##### 第四节 2021年中国IC封装产思考

###### 一、技术上：引进和创新相结合

###### 二、人才上：引进和培养相结合

###### 三、资金上：资本运作是主要途径

#### 第五章 2021年中国IC封装技术研究

##### 第一节 中国IC封装技术热点聚焦

##### 第二节 高端IC封装技术

###### 一、IC制造技术

二、TAB Potting System

三、BGA , CSP BallMounting System

四、Flip-Chip Bonding System

五、TAB Marking System

六、TFT-LCD Cell Bonding System

第六章 2016年中国高端IC-3D封装市场探析（3D-IC封装）

第一节 3d集成系统分析

一、3D-IC封装

二、3D-IC集成

三、3D-SI集成

第二节 2016年中国高端IC-3D封装发展总况

一、3D-IC技术蓬勃发展的背后推动力

二、3D-IC封装的快速普及

三、3D封装技术将显著提升电源管理器件性能

四、3D-IC明后年增温 封装大厂已积极部署

五、3D封装领域：后进入公司成长空间更大

六、3D封装技术解决芯片封装日益缩小的挑战

七、3D-IC是半导体封装的必然趋势预测分析

第三节 高端IC-3D封装研究进展

一、3D芯片封装技术创新

二、tb级3D封装存储芯片

第四节 3D-IC集成封装系统（sip）的可行性研究

第七章 中国IC封装测试领域深度剖析

第一节 中国IC封装测试业运行总况

一、IC封装测试业外资独占鳌头

二、测试企业布局力度将加大

三、中高档封测产品占比将逐年提升

四、应对知识产权、环保考验

第二节 新型封装测试技术

一、MCM（MCP）技术

二、SiP封装测试技术

三、MEMS技术

四、BCC封装技术

五、Flash Memory（TSOP）塑封技术

六、多种无铅化塑封技术

七、汽车电子电路封装测试技术

八、Strip Test（条式/框架测试）技术

九、铜线键合技术

第八章 2017-2021年中国IC封装所属产业数据监测分析

第一节 2017-2021年中国IC封装所属行业规模分析

一、企业数量增长分析

二、从业人数增长分析

三、资产规模增长分析

第二节 2021年中国IC封装所属行业结构分析

一、企业数量结构分析

1、不同类型分析

2、不同所有制分析

二、销售收入结构分析

1、不同类型分析

2、不同所有制分析

第三节 2017-2021年中国IC封装所属行业产值分析

一、产成品增长分析

二、工业销售产值分析

三、出口交货值分析

第四节 2017-2021年中国IC封装所属行业成本费用分析

一、销售成本统计

二、费用统计

第五节 2017-2021年中国IC封装所属行业盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

二、主要盈利能力指标分析

第二部分 市场深度剖析

第九章 2021年中国IC封装产业运行新形势透析

第一节 2021年中国IC封装产业运行综述

一、大陆IC封装企业的分布及其特点

二、IC封装向高端技术迈一步

三、形成封装及自主品牌终端产业链

第二节 2021年中国IC封装产业变局分析

第三节 国际形势对中国IC封装业影响及应对分析

第四节 2021年中国IC封装业面临的挑战分析

第五节 对发展我国IC封装业的思考

## 第十章 2021年中国IC封装细分市场运行分析

### 第一节 手机IC封装市场

#### 第二节 手机基频封装

#### 第三节 智能手机处理器产业与封装

#### 第四节 手机射频ic

##### 一、手机射频IC市场

##### 二、手机射频IC产业

##### 三、4G时代手机射频IC封装

#### 第五节 pc领域先进封装

##### 一、Strip Test产业近况

##### 二、DRAM封装

##### 三、NAND闪存产业现状调研

##### 四、NAND闪存封装发展

##### 五、CPU GPU和南北桥芯片组

## 第十一章 2021年中国封装用材料运行分析

### 第一节 金线

### 第二节 IC载板

## 第十二章 2021年中国分立器件的封装发展透析

### 第一节 半导体产业中有两大分支

#### 一、集成电路

#### 二、分立器件

##### 1、特点

##### 2、应用

### 第二节 分立器件的封装及其主流类型

#### 一、微小尺寸封装

#### 二、复合化封装

#### 三、焊球阵列封装

#### 四、直接FET封装

#### 五、IGBT封装

#### 六、无铅封装

### 第三节 2021年中国分立器件的封装现状综述

#### 一、分立器件封装特点

#### 二、分立功率半导体市场在封装革命与集成器件挑战下持续扩张

#### 三、中国分立器件商贸市场分析

#### 四、分立器件封装低端市场竞争激烈

五、分立器件：汽车与照明市场扩容 封装重要性凸显

六、封装产品结构调整分立器件价格影响

七、集成电路及分立器件封装测试项目

第三部分 产业竞争力测评

第十三章 2021年中国IC封装产业竞争新格局探析

第一节 2021年中国IC封装竞争总况

一、封装市场竞争激烈

1) 全球封装行业的竞争格局

2) 国内封装行业的竞争格局

二、倒装芯片封装更具竞争力

三、封装低端市场竞争力加强

四、IC封装技术竞争力分析

五、外资加大中国市场布局对产业竞争的影响

第二节 2021年中国IC封装产业集中度分析

一、市场集中度分析

二、生产企业集中度分析

第三节 2022-2027年中国IC封装竞争趋势预测

第十四章 2021年中国半导体（集成电路）封装重点企业运营财务状况分析

第一节 长电科技（600584）

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业发展规划

第二节 深圳赛意法微电子有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业发展规划

第三节 南通富士通微电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业发展规划

第四节 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

第五节 英特尔产品（成都）有限公司

一、企业概况



## 二、企业主要经济指标分析

### 第六节 无锡菱光科技有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

### 第七节 恒宝股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

### 第八节 南京汉德森科技股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

### 第九节 比亚迪半导体股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

### 第十节 江苏欧密格光电科技股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

## 第十五章 2021年中国芯片封装重点企业关键性财务指标分析

### 第一节 安靠封装测试（上海）有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

### 第二节 沛顿科技（深圳）有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

### 第三节 山东凯胜电子股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

### 第四节 河南省鼎润科技实业有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

## 第十六章 2021年中国封装材料企业运营竞争性指标分析

### 第一节 衡所华威电子有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

### 第二节 无锡嘉联电子材料有限公司

#### 一、企业概况

## 二、企业主要经济指标分析

### 第三节 福建易而美光电材料有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

### 第四节 无锡创达新材料股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

### 第五节 鼎贞（厦门）系统集成有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

### 第六节 无锡市江达五金贸易有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

### 第七节 咸阳华电电子材料科技有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

## 第四部分 产业与投资战略部署

### 第十七章 2022-2027年中国IC封装业前景预测分析

#### 第一节 2022-2027年中国IC封装业前景预测分析

##### 一、环氧树脂在电子封装应用方面前景开阔

##### 二、太阳能光伏行业对封装材料需求前景光明

#### 第二节 2022-2027年中国IC封装产业新趋势探析

##### 一、新型的封装发展趋势预测分析

##### 二、集成电路封装的发展趋势预测分析

##### 三、IC封装技术发展趋势预测分析

##### 四、IC封装材料市场发展趋势预测分析

##### 五、半导体IC封装技术发展方向

#### 第三节 2022-2027年中国IC封装市场前景预测分析

##### 一、全球代表性IC封装厂家收入预测分析

##### 二、中国IC封装市场规模预测分析

#### 第四节 2022-2027年中国IC封装市场盈利预测分析

### 第十八章 2022-2027年中国IC封装业投资价值研究

#### 第一节 2021年中国IC封装产业投资概况

##### 一、IC封装业投资特性「HJ LT」

##### 二、IC封装产业投资准入状况分析

### 三、IC封装投资在建项目分析

### 四、IC封装投资周期分析

#### 第二节 2022-2027年中国IC封装投资机会分析

##### 一、IC封装区域投资潜力

##### 二、IC封装产业链投资热点分析

##### 三、与产业政策调整相关的投资机会分析

#### 第三节 2022-2027年中国IC封装投资风险预警

##### 一、宏观调控政策风险

##### 二、市场竞争风险

##### 三、技术风险

##### 四、市场运营机制风险

##### 五、外资加大中国市场投资影响分析

#### 第四节 行业投资观点

##### 图表目录：

图表1：2017-2021年中国国内生产总值统计分析

图表2：2017-2021年全国居民消费价格上涨状况分析

图表3：2017-2021年全国居民人均可支配收入及其增长速度

图表4：2021年中国社会固定资产投资分析

图表5：2017-2021年中国进出口贸易总额

图表6：2017-2021年中国IC封装测试行业产能分析

图表7：2017-2021年中国IC封装所属行业从业人员数量分析

图表8：2017-2021年中国IC封装所属行业资产规模分析

图表9：2021年中国不同类型IC封装企业数量结构分析

图表10：2021年中国不同所有制IC封装企业数量结构分析

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/electric/780755.html>